



证券代码：300567

证券简称：精测电子

编号：2023-006

## 武汉精测电子集团股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称及人员姓名	广发证券姚佳，民生证券周晓萌，长江证券王泽罡，东方证券李庭旭、江舟，华泰证券吕兰兰，国寿养老周晓文，招商基金邓新翱，博时基金李喆，兴业基金高观朋，国泰基金谢泓材，咏明资产陈上，上海复胜资产赵超，东证融汇资产刘迪，上海阿杏投资刘畅，弘尚资产江凡，浙商资管鲁立，远信投资袁迦昌，田鼎投资肖建国，上海仙人掌私募刘晓，易米基金杨臻，上海合远基金蔡宗伯、管华雨，嘉合基金梁超逸，高毅资产朱春禹，英鑫私募黄鑫等 26 余人（排名不分先后）
时间	2023 年 9 月 5 日
地点	上海市青浦区赵巷镇沪青平公路 2875 号
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：刘炳华先生 上海精测投融资总监：李国先生
投资者关系活动主要内容介绍	<b>Q1:公司 2023 年上半年主要经营情况介绍。</b> A: 2023 年上半年，公司继续加大战略研发投入，不断优化产品和客户构成，强化产品升级并加强研发创新，各项业务均取得了较大的突破和进展。在显示测试领域，不断突破创新，积极调整产品结构，加大了面板中、前道制程设备、智能和精密光学仪器以及 OLED、Mini-LED、Micro-OLED、Micro-LED 等新型显示产品研究开发力度，进一步提高海外核心客户的扩展力度；同时，公司不断优化内部管理水平，持续提升精益生产管理能力和加强成本控制。2023 年上半年，显示测试领域毛利率相较于去年



同期增加 2.38%，公司在显示测试领域综合竞争力以及行业地位得到进一步提高；在半导体测试领域，无论是技术、产品，还是市场方面均取得了较大突破，多款产品已在国内主要集成电路厂商取得重复批量订单，并打破国外厂商垄断，国产化进程进一步加快；在新能源领域，相关产品研发工作已取得重要进展，部分产品已通过目标客户的认证并实现大规模销售，同时，进一步加大了国内外客户的开拓力度。

2023 年上半年，公司实现营业收入 111,042.92 万元，同比增长 0.46%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,209.40 万元，同比减少 58.56%；报告期末公司总资产为 879,274.18 万元，较期初增长 17.65%；归属于上市公司股东的净资产为 346,720.84 万元，较期初增长 7.51%。

**Q2:公司在手订单情况如何？**

A: 公司半导体、新能源领域订单相较于去年上半年实现了较大幅度增长，截止《2023 年半年度报告》披露日，公司取得在手订单金额总计约 31.30 亿元，其中半导体领域订单约 13.65 亿元、新能源领域订单约 5.13 亿元。

**Q3:2023 年上半年公司研发投入情况如何？**

A: 2023 年上半年，公司继续保持研发投入强度，研发投入 29,331.55 万元，较上年同期增长 22.78%，占营业收入 26.41%。其中，显示检测领域研发投入 14,544.55 万元，较上年同期增长 6.22%；半导体检测领域研发投入 10,197.14 万元，较上年同期增长 26.10%；新能源领域研发投入 4,589.86 万元，较上年同期增长 117.53%。

**Q4: 公司 2023 年上半年净利润下滑的原因。**

A: 公司 2023 年上半年研发投入 29,331.55 万元，较上年同期增长 22.78%（其中在半导体领域研发投入 10,197.14 万元，较上年同期增长 26.10%；显示领域研发投入 14,544.55 万元，较上年同期增长 6.22%；在新能源领域研发投入 4,589.86 万元，



较上年同期增长 117.53%)，加之股权激励费用及资产的折旧摊销费用增加等因素，对公司报告期内净利润造成了较大的影响。

**Q5：公司半导体量检测业务现状如何？**

A：目前公司是国内半导体检测设备领域领军企业之一，已基本形成在半导体检测前道、后道全领域的布局。

公司子公司武汉精鸿主要聚焦自动测试设备（ATE）领域（主要产品是存储芯片测试设备），老化（Burn-In）产品线在国内一线客户实现批量重复订单、CP（Chip Probe，晶片探测）/FT（Final Test，最终测试，即出厂测试）产品线相关产品已取得相应订单并完成交付，目前批量订单正在积极争取中。

公司子公司上海精测主要聚焦半导体前道检测设备领域，致力于半导体前道量测检测设备的研发及生产，设备应用于硅片加工、晶圆制造、科研实验室、第三代半导体四大领域。上海精测膜厚系列产品、OCD 设备、电子束设备已取得国内多家客户的批量订单；半导体硅片应力测量设备也取得客户重复订单；明场光学缺陷检测设备已完成首台套交付，且已取得更先进制程订单；有图形暗场缺陷检测设备等其他储备的产品目前正处于研发、认证以及拓展的过程中。

随着公司技术水平的不断提高、产品成熟度以及市场对公司产品的认可度不断提升，公司半导体检测业务开拓迅速，订单以及销售收入持续增长。2023 年上半年公司在整个半导体板块实现销售收入 12,262.34 万元，较上年同期增长 79.22%。

目前公司核心产品已覆盖 2xnm 及以上制程，先进制程的膜厚产品、OCD 设备以及电子束缺陷复查设备已取得头部客户订单，随着制程越来越先进、工艺环节不断增加，行业发展对工艺控制水平提出了更高的要求，制造过程中检测设备与量测设备的需求量将倍增。未来，公司将继续深耕集成电路领域，面向世界科技前沿，加大研发投入，不断推进光学检测和电子光学检测两大方向半导体前道量测和测试领域的关键设备研发及产品迭代，提升



	<p>公司自主研发创新力，致力于打破目前集成电路高端检测设备被国外厂家垄断的局面，不断推进、引领半导体检测设备国产替代化进程。</p> <p><b>Q6：公司在半导体前道量测领域的客户扩展情况如何？</b></p> <p>A：上海精测目前国内主要客户市场开拓顺利，半导体客户群体广泛，涵盖了逻辑工艺、存储工艺、第三代半导体工艺等国内快速发展中的合作伙伴。</p> <p><b>Q7：半导体检测设备的验证周期及交付周期如何？</b></p> <p>A：半导体检测设备验证周期长短受设备类型、客户要求、现场环境等多方面因素的影响，现阶段行业普遍在 6-18 个月左右；目前设备的交付周期普遍在 6 个月以上，国外厂商的交付周期一般长达 12 个月以上。</p> <p>接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 9 月 5 日